

Title (en)  
METHOD FOR INTEGRATING AT LEAST ONE ELECTRONIC ELEMENT IN A TABLE TOP OBTAINED BY MOULDING, TABLE TOP OBTAINED

Title (de)  
INTEGRATIONASVERFAHREN MINDESTENS EINES ELEKTRONISCHEN ELEMENTS IN EINE TISCHPLATTE, DIE DURCH FORMGUSS ERZEUGT WIRD, SO ERZEUGTE TISCHPLATTE

Title (fr)  
PROCEDE D'INTEGRATION D'AU MOINS UN ELEMENT ELECTRONIQUE DANS UN PLATEAU DE TABLE OBTENU PAR MOULAGE, PLATEAU OBTENU

Publication  
**EP 3546164 A1 20191002 (FR)**

Application  
**EP 19165174 A 20190326**

Priority  
FR 1870377 A 20180330

Abstract (fr)  
L'objet de l'invention est un procédé d'intégration d'au moins un élément électronique, notamment un dispositif de rechargement dans un plateau de table (10), obtenu par moulage, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :- Préparation d'un moule (16) doté en paroi inférieure d'au moins un piston mobile (18) en translation au profil d'un logement (26) ménagé dans ledit plateau, ledit piston faisant saillie de ladite paroi inférieure dudit moule (16),- Dépose d'une quantité de matériau pulvérulent et/ou fibreux associé à un liant dans le moule (16) ainsi préparé,- Pressage à froid avec une presse à froid de l'ensemble de la surface dudit matériau pulvérulent disposé dans le moule (16), ladite presse à froid comprenant au moins un contre-poinçon (22), disposé au droit du piston mobile (18), l'épaisseur initiale étant réduite à l'épaisseur- Retrait de la presse à froid- Mise en place de l'élément électronique dans le logement (26) et mise en place d'un matériau de comblement du logement (26),- Premier pressage à chaud avec une presse à chaud de façon à assurer la cohésion du liant et de façon à obtenir un plateau de table (10) plan en partie supérieure,- Retrait de la presse à chaud,- Obtention d'un plateau de table (10) avec un élément électronique intégré.

IPC 8 full level  
**B27N 3/00** (2006.01); **A47B 13/08** (2006.01); **B27N 3/02** (2006.01); **B27N 3/04** (2006.01); **B27N 3/18** (2006.01); **B27N 3/20** (2006.01); **B30B 11/02** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**A47B 13/08** (2013.01); **A47B 96/205** (2013.01); **B27N 3/00** (2013.01); **B27N 3/02** (2013.01); **B27N 3/04** (2013.01); **B27N 3/18** (2013.01); **B27N 3/203** (2013.01); **B30B 11/027** (2013.01)

Citation (search report)  
• [A] US 2011257566 A1 20111020 - BURDEA GRIGORE C [US], et al  
• [A] JP S60119508 U 19850813  
• [A] GB 1124513 A 19680821 - SCHNITZLER ERWIN

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3546164 A1 20191002**; FR 3079441 A1 20191004

DOCDB simple family (application)  
**EP 19165174 A 20190326**; FR 1870377 A 20180330